

ウェハ クラック・エッジ 検査装置 特許出願中

WAFER CRACK & EDGE INSPECTION SYSTEM



従来の半導体検査装置の常識を破る低価格。



他に類を見ない、独自の光学系・撮像技術で、高速・高検出能力。



1台で複数種の欠陥を検出。



《クラック検査

- 目視検査では発見し辛い、ウェハのクラックを高速に撮像、検出します。
- スループット 1秒/1枚
- 特殊な光学系を用い、弊社独自の光学技術・画像処理技術でクラックを検出します。
- マップ上の不良チップをマップに反映。(オプション)

検出可能欠陥

- クラック
- ディンプル
- ソーマーク
- スリップ
- マウンド・隆起

《エッジ検査

- ウェハの外周のエッジの欠陥を高速に撮像、検出します。
 - スループット 4.5秒/1枚 (8inch ウェハ)
 - 上下ベベル、APEXを検査します。
- ※ノッチ検査についてはご相談ください。

検出可能欠陥

- クラック
- キズ
- 膜残り
- チッピング
- 異物